

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☒线上交流 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	兴全基金、华安基金、摩根基金、景顺长城基金、长信基金、中金资管、长城基金、太保资产、申万宏源证券、融通基金、西部证券、申万菱信基金、东方财富证券、光大永明、中加基金、广发基金、建信基金、华福证券、华富基金、招商基金、华夏基金、华泰柏瑞、兴业基金、交银施罗德、华泰保险、中信保诚、国泰基金、鹏扬基金、永赢基金、信达澳亚、友邦保险、汇安基金、鹏华基金、大成基金、工银瑞信、诺安基金、海富通基金、农银汇理基金、财通基金、中银基金、中国人保、上海瓦洛兰、富安达基金、浦银安盛、Grand Alliance Asset Management、华泰保兴、中金公司、国金证券、高毅资本、太平基金、博道基金、泰康资产、民生加银基金、华商基金、宝盈基金、圆石投资、重阳投资、涌乐基金、建信养老、富国基金、Keystone Investors、南京证券股份有限公司、中英人寿、广发资管、华宝基金、煜德投资、盘京投资、国元证券、广发证券、天弘基金、新华资产、浙江壁虎投资管理有限公司、浦发银行、中再资产、红土创新基金、新华基金、趣时资产、玖鹏资产、盛宇基金、聚鸣投资、上海水璞、平安资产、财通资管、国信证券、永安国富资产管理有限公司、深圳鑫泰禾私募基金管理有限公司、创金合信、恒泰证券股份有限公司、深圳前海佳世财富管理有限公司、Polunin Capital Partners、中银国际证券、泰康基金、深圳市高新投集团、深圳市嘉亿资产管理有限公司、万和证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、首创证券、平安证券、新疆前海联合基金管理有限公司、江海证券、海港人寿保险股份有限公司、华安证券、华安财保资产管理有限公司、华源证券、Nature Capital、上汽集团尚颀资本、上海日胜隆基金、上海渊泓投资管理有限公司、中信保诚、丹羿投资、九泰基金、交银施罗德、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司、华安基金、华泰保兴基金、南京证券股份有限公司、国金自营、富国基金、富安达基金、弘毅远方基金、摩根士丹利基金、新华基金、江信基金、浦银安盛基金、湘财基金、蝴蝶兰家办、财通基金、财通证券资管、达诚基金、长安基金、长盛基金、高毅投资等 132 家机构
时间	2026 年 5 月 12 日-2026 年 7 月 15 日
地点	现场交流、公司会议室

公司接待人员	1、董事会秘书、财务总监 陆春龙 2、证券事务代表 李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的 EDA 软件、PDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，聚焦芯片成品率提升与电性测试快速监控业务，同时布局光子芯片设计技术，是国内外多家大型集成电路企业的重要合作伙伴。公司提供 EDA 软件、PDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备及成品率提升全流程解决方案，贯穿集成电路设计至量产全周期，助力提升芯片性能、成品率与稳定性，成功案例覆盖多个集成电路先进工艺节点。 二、问答环节 1、公司软硬件业务之间毛利率存在差异，请问 2025 年各业务毛利表现及后续变化趋势？ 2025 年公司软硬件业务毛利表现有所分化。软件开发及授权实现收入 2.78 亿元，同比增长 75.13%，毛利率为 69.95%，同比下降 16.01 个百分点，主要系公司总包服务承接能力快速提升，但部分后端设计服务需与合作方协同完成，外协成本上升所致，这是业务规模扩大下的主动战略选择；测试设备及配件实现收入 4.53 亿元，同比增长 17.30%，毛利率 50.42%，同比基本保持稳定。展望后续，随着公司综合服务能力持续增强，外部协作成本将有效降低，软件毛利率有望企稳回升；同时，硬件关键部件国产化替代持续推进，有助于设备毛利率逐步改善。长期来看，随着软件业务收入占比持续提升，公司综合毛利率有望呈现结构性改善趋势。 2、请问公司收购 LUCEDA 后，目前整合进度如何？是否有进一步并购硅光产业链的规划？ 公司的战略方向是加码硅光全产业链布局，依托 LUCEDA 的技术积淀与广立微的市场优势，公司将逐步覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升全环节，打造系统性解决方案。在整合方面，管理和业务整合符合公司整体预期，2025 年 LUCEDA

	发布了业界首款硅光异质异构集成 PDK，并与公司合作推出了 DE-Photonics 和 PhotonicsDRC 工具，业务协同进展高效。2026 年 5 月的新品发布会推出的 Photonix 1.0 亦是双方协同的重要成果。 关于并购，公司将基于公司总体的战略规划，立足自身稳健发展的同时，综合考虑并购计划。后续如有，公司将严格按照信息披露要求履行披露义务。 3、通用 AI 大模型的快速发展，对公司的数据分析平台业务有何影响？相关的产品进展有哪些？ 通用 AI 大模型的快速爆发，为半导体软件带来了从“工具化”向“智能化”跨越的历史性机遇。面对这一产业趋势，公司已将 AI 技术与业务的深度融合确立为核心战略方向。公司 DATAEXP 平台践行“以数据为底座，以 AI 为引擎”的理念，致力于打通半导体从设计、制造到封测的全链路数据壁垒，将分散的经验转化为可复用、可进化的智能分析能力。 2026 年 5 月，公司推出了 SemiClaw1.0、MuseLab1.0、INF-TPC1.0 等多款 AI 战略级新品，核心定位是将 AI 能力深度嵌入半导体良率管理的具体工作场景： SemiClaw 1.0 是公司自研的企业级自主 AI 智能体中台，赋能用户便捷搭建具备业务执行能力的数字工程师与 DataExp 平台深度融合交互，结合广立微多年积累的良率分析 Skill；支持自然语言驱动数据调取、专业根因分析到标准报告输出。 MuseLab 1.0 是专为半导体研发打造的 AI 数据分析专家智能体，覆盖 CP/FT/WAT 全制程高阶归因，具备业务记忆沉淀能力，可将工程师的分析经验转化为可复用的 Know-how 资产。 INF-TPC 1.0 是基于 AI 算法的工艺机台 FDC Raw Trace 实时异常检测平台，采用无监督学习与有监督训练双算法引擎，实现点维度实时监控，为工厂 FDC 数据分析提供更高阶、更智能的分析监控方案，从根本上减少因机台异常导致的晶圆报废率，直接降低客户的制造损耗。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无。
日期	2026 年 7 月 15 日